

广州方邦电子股份有限公司

关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月23日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“挠性覆铜板生产基地建设项目”的后续产能建设，其他募投项目不变。公司董事会、监事会及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

● “挠性覆铜板生产基地建设项目”原计划拟使用募集资金55,194.63万元。截至2023年12月31日，该项目累计投入募集资金24,890.30万元，投入进度为45.10%，正在进行小批量生产，部分系列的无胶FCCL产品认证顺利，已在2023年第二季度起逐步落实小额订单。本项目第二期建设正在进行中，预计于2024年第二季度末达到可使用状态，届时将合计达到32.5万平方米/月的产能。在上述产能建设完成后，公司拟终止本项目后续产能建设。

● 拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设的原因，一方面是近年来受宏观环境及经济周期等外部环境的影响，挠性覆铜板产业链下游需求放缓；另一方面是公司采取自研自产原材料的策略来生产挠性覆铜板，以逐步打破对国外上游供应链的依赖，建立核心竞争优势和技术壁垒，大幅降低生产成本，提升产品市场竞争力和经济效益，但实施难度较大、周期长，须稳步推进。因此公司动态调整相关产能布局规划，是更为稳健的经营策略选择，有利于长远发展。

● 本项目募集资金预计剩余金额 30,068.08 万元, 将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。后续公司将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目, 待审慎研究讨论确定后, 将严格按照相关法律法规的规定, 履行相应的审议和披露程序后实施新项目投资。

一、募投项目概况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212号文核准, 并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式, 向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2,000 万股, 发行价为每股人民币 53.88 元, 共计募集资金 107,760.00 万元, 扣除承销和保荐费用 7,776.60 万元后的募集资金为 99,983.40 万元, 已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后, 公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验(2019)7-65号)。

二、募投项目投入情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司首次公开发行股票募投项目投入情况如下:

序号	募投项目	计划投资金额(万元)	累计投入金额(万元)	投入进度(%)	项目状态
1	挠性覆铜板生产基地建设项目	55,194.63	24,890.30	45.10	详见下文
2	屏蔽膜生产基地建设项目	13,251.28	11,421.09	86.19	2023 年 2 月已结项
3	研发中心建设项目	20,206.00	8,987.31	44.48	于 2022 年 12 月达到可使用状态, 目前进入研发项目的实施阶段
4	补充营运资金项目	9,252.05	9,315.09	100.68	已结项
	合计	97,903.96	54,613.79	55.78	

三、拟终止部分募投项目情况及原因

（一）拟终止部分募投项目计划与实际投资情况

本次拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”的后续产能建设。本项目拟使用募集资金金额 55,194.63 万元，建设期 2 年，第 3 年初开始生产，第 5 年达产。项目全部达产后形成 60 万平方米/月的挠性覆铜板（FCCL）产能。但由于建设期内境内外疫情反复、境外设备供应商产能紧张等因素，项目整体进度有所延后。公司分别于 2021 年 9 月 18 日和 2022 年 4 月 22 日发布了募投项目延期公告。截至 2023 年 12 月 31 日，本项目累计投入募集资金金额 24,890.30 万元，投入进度为 45.10%。

本项目第一期已于 2022 年 12 月达到可使用状态，具备 10 万平方米/月的产能，正在进行小批量生产。部分系列的无胶 FCCL 产品认证顺利，客户反馈良好，已在 2023 年第二季度起逐步落实小额订单。

本项目第二期建设正在进行中，部分产线预计于 2024 年第二季度末达到可使用状态，届时本项目将合计达到 32.5 万平方米/月的产能。第二期的建设进展较原计划有所延期，主要原因为项目关键设备高温压合机须从日本进口，而日本供应商产能紧张，公司二期部分设备订单预计于 2024 年 4 月交付。在上述产能建设完成后，公司拟终止后续产能建设。

（二）拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设的原因

我国挠性覆铜板产业虽然经过了几十年的发展有了很大的进步，但总体水平仍然较低，仍以普通产品居多，专用化、功能化、高性能产品较少，附加值不高。相较日本、韩国的头部企业，国内的挠性覆铜板企业在产品规模和技术实力等方面都相对落后，主要原因是生产挠性覆铜板所需的高端铜箔和电子级聚酰亚胺（PI/TPI）被日本、美国、韩国的相关企业长期垄断。面对挠性覆铜板的全球竞争格局现状，公司在申请首发上市期间规划募投项目时根据当时市场环境预测产品下游需求稳步增长，希望借助该项目，依托多年研发生产电磁屏蔽膜所积累的真空溅射、精密涂布、电化学以及配方合成等核心技术，采取自研自产 RTF 铜箔和 PI/TPI 等原材料的策略来生产挠性覆铜板，以逐步打破对国外上游供应链的依赖，建立核心竞争优势和技术壁垒，大幅降低生产成本，提升产品市场竞争力和经济效益，同时丰富公司的产品结构，扩大业务规模，助力公司早日成为国内乃至全球范围内具有代表性的高端电子材料厂商。

然而在项目实施过程中，受下游市场环境变化、研发和客户认证周期较长等因素影响，公司动态调整相关产能布局规划，有利于公司的长远发展。

一方面，近年来受宏观环境及经济周期等外部环境的影响，挠性覆铜板产业链下游需求放缓。以智能手机、PC 为代表的消费电子领域是挠性覆铜板的主要终端应用场景，但近年来手机和 PC 的全球出货量总体下滑，根据 IDC、Gartner 等机构数据，2022-2023 年全球智能手机出货量分别为 12.06 亿部和 11.67 亿部，均为 2014 年以来的新低值，较 2017 年巅峰期的 14.72 亿部分别下降了 18.13% 和 20.75%；2022-2023 年全球个人电脑市场总出货量分别为 2.84 亿台、2.42 亿台，同比分别下降 16.88% 和 14.84%。挠性覆铜板的下游客户 PCB/FPC 厂商受终端需求疲软影响，再叠加行业内扩充产能陆续释放，增长动能明显减弱。

另一方面，公司对 FCCL 的战略定位和技术路径，创新性强、预期效益高，但实施难度较大、周期长，须稳步推进。相较于当前市场主流 FCCL 厂商长期使用日本、美国相关企业的铜箔、PI/TPI 作为原材料，公司采用自研自产原材料的战略定位和技术路径实施难度更大，需要更长的研发周期和客户认证周期，包括对自产铜箔和 PI/TPI 的物性（如自产 FCCL 用铜箔的表面粗糙度、耐弯折、延展性等，自产 PI/TPI 的组分构成、涉及的模量、吸水性、介电常数以及介电损耗等相关参数）、FPC 制程能力以及成品可靠性等内容进行反复测试认证。当前公司挠性覆铜板的研发和客户认证工作有序开展、成效良好，公司使用自研自产原材料生产 FCCL 的战略定位和技术路径已得到一定程度验证：使用自产铜箔生产的 FCCL 产品已在 2023 年二季度起落实小额订单，预计 2024 年起逐步形成规模销售；使用自产铜箔+自产 PI/TPI 生产的产品，将进一步降低生产成本，提升市场竞争力和经济效益，预计该品类产品于 2024 年通过更多下游认证，后续订单量逐步爬坡，需一定时间以实现大规模量产并进入国内外头部 FPC 客户的供应链。

综上考虑，当前阶段终止本项目后续产能建设，全力消化已有产能，同时预留时间为公司 FCCL 产品的技术路径和产品参数提供充分验证，是更为稳健的经营策略选择。

（三）拟终止募投项目的募集资金使用及节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次拟终止募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额(A)	累计已实际支付募集资金金额(B)	已签订合同待支付金额(C)	预留铺底流动资金(D)	利息收入扣除手续费后净额(E)	募集资金预计剩余金额(F=A-B-C-D+E)
挠性覆铜板生产基地建设项目	55,194.63	24,890.30	4,593.85	1,591.57	5,949.17	30,068.08

注：1、募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入；

2、已签订合同待支付金额是公司根据已经签署的有关合同和协议将在后续进行支付的款项，其中部分货款需通过外币支付，在上表列示时采用即期汇率折算，最终支付金额以实际情况为准；

3、预留铺底流动资金为公司根据已有产能订单爬坡速度等因素综合测算，为保障已有产能的后续生产经营而预留的支出金额。

四、拟终止部分募投项目对公司生产经营产生的影响

公司拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设，是根据目前公司的实际经营情况以及 FCCL 业务的战略定位和技术实施路径，从审慎控制经营风险的角度出发而作出的决定，目的是为了能够更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律法规的要求，加强募集资金使用的监督，确保募集资金合法、有效和安全的使用。

五、本次拟终止“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设后结余募集资金的计划使用情况

终止本项目后续产能建设后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

后续公司将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目，待审慎研究讨论确定后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序后实施新项目投资。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年2月23日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募投项目之“挠性覆铜板生产基地建设项目”后续产能建设。本次终止事项符合公司实际情况，有利于公司稳健经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事参与董事会决策并对所审议事项发表了明确意见。

（二）监事会意见

公司于2024年2月23日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》。监事会认为：公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。

综上，保荐机构对公司本次终止首次公开发行股票部分募投项目事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2024年2月24日